

## Elektrischer Test: 100% bestanden

Endplattenstärke: 1,8 +/- 0,15 mm

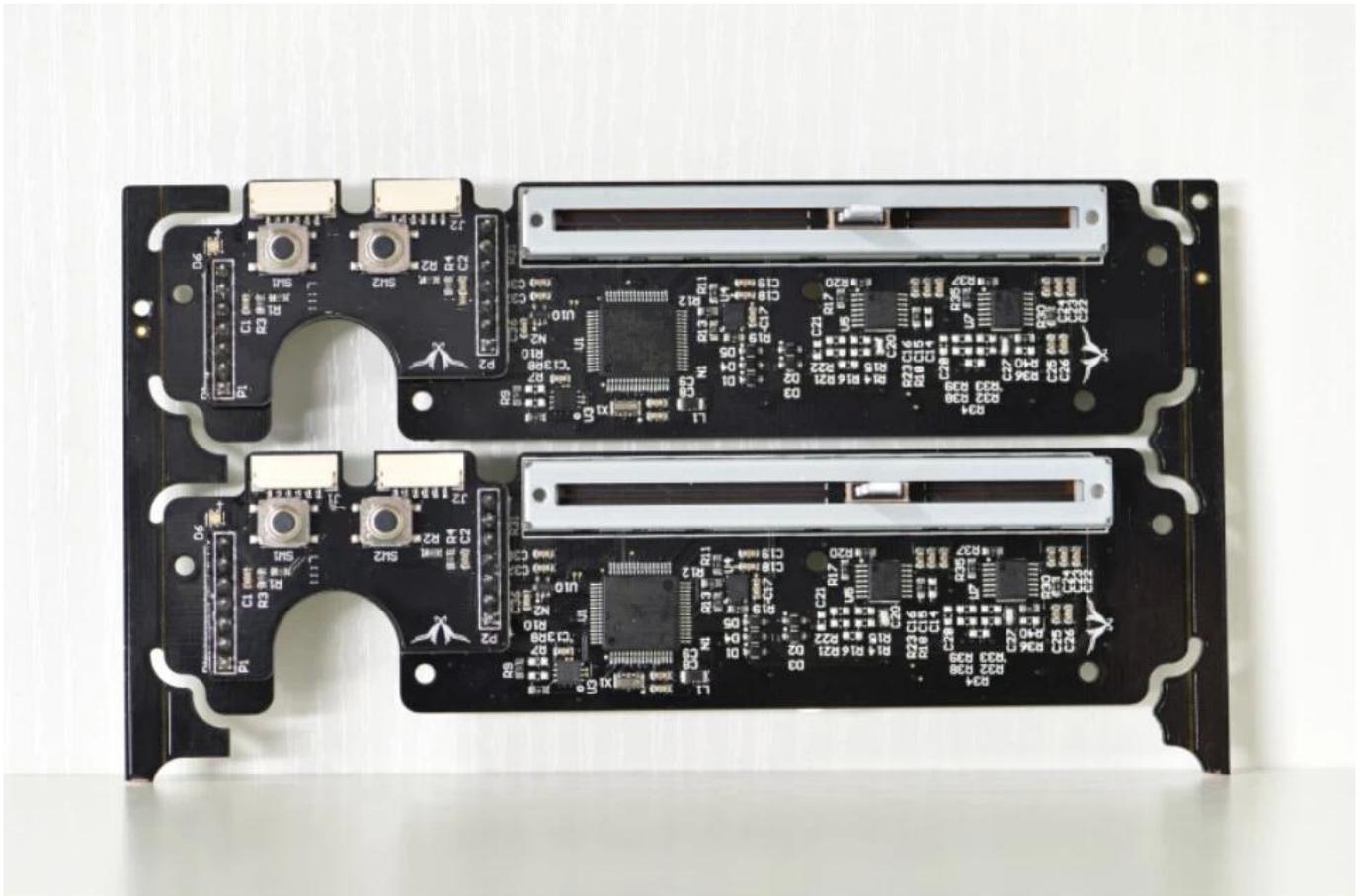
OBERFLÄCHE: DIESE BOARD WIRD IMMISSIONSGOLDIERT NACH IPC-6012.  
DICKE soll 0,050 µM über 3-6 µM NICKEL sein.

KUPFERPLATTENLÖCHER MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER KÖNNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN,

## Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen:	Vakuumverpackt
Lieferdetails:	7-10days





[Leiterplatte Unternehmen, hochwertige Leiterplattenhersteller](#)